



綠固科技股份有限公司

GREENCURE TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED

--- PCB INK & TOUCH PANEL INK ---

108-22, Lin 10, Zhen-Hsing Li, Ping-Zhen City, Taoyuan Hsien, 324 Taiwan
Tel: 886-3-4964915 Fax: 886-3-496-4858

感光型防焊阻劑 Liquid Photo-imaginable Solder Mask **LM-600 E5GB**

LM-600 為一種接觸曝光鹼液顯影型之防焊阻劑，為一性能優異的網印印刷油墨，顯影後忠於底片具有高度之解像力。此二液型感光防焊阻劑經高溫後硬化之塗膜具高絕緣性及高耐焊性，產品性質優越，適用於 PCB 精密製造。

LM-600 series are screen-printing contact exposure type photo-imaginable mask designed for printed circuit fabrication. It has sharp pattern, high resolution, high color stability for long baking time at high temperature and excellent electric properties. Also has fast curing speed, excellent printing properties and forming a tough protective film with excellent solder resist properties after post-curing for the production of PCB which require fine pattern with high density packaging.

技術資料 Technical Data

特性 Feature	品名 Number	LM-600 E5GB
顏色 Color		綠色 Green
不揮發性 Solid content		75 ± 2%
黏度 Viscosity VT-04F viscometer #2 號針,#2 Spindle (25°C) Viscosity at 25°C		A 劑 (Component A): 260±60ps B 劑 (Component B): 150±20ps
硬化條件 Curing Condition		紫外線曝光加熱後硬化 UV Exposure and thermal curing
耐焊性 Resist		260±5°C, 10 秒 seconds, ≥3 次
鉛筆硬度 (JIS K5400) Film hardness by pencil lead		≥ 6H
密著性 (JIS D020)		100/100
耐溶劑性 Solvent resistance, dichloro methane, room temperature		30 分鐘 minutes
抗酸性 Acid resistance	10% HCl 25°C	30 分鐘 minutes
	10% H ₂ SO ₄ 25°C	30 分鐘 minutes
抗鹼性 Base resistance, 10% NaOH 25°C		30 分鐘 minutes
絕緣抵抗 Electric Insulation resistance	起始值 initial value	≥ 1 x 10 ¹³ Ω
	65°C, 95%RH, 500H	≥ 1 x 10 ¹¹ Ω
解像度 Resolution (Line/Space)		50 μm
化學鍍金 Non-electrolysis Gold-Plating		≥ 0.03 μm
耐燃性		UL 94V-0 (File No. E225462)
儲存安定性 Sheif life at 20-30°C under dark packing		6 個月 month

Ver. 20060103



綠固科技股份有限公司

GREENCURE TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED

--- PCB INK & TOUCH PANEL INK ---

108-22, Lin 10, Zhen-Hsing Li, Ping-Zhen City, Taoyuan Hsien, 324 Taiwan
Tel: 886-3-4964915 Fax: 886-3-496-4858

使用說明 Working process

混合比例 mixing ratio(重量比 by weight)	主劑(A) 700g : 硬化劑(B) 300g
使用期限 Pot life	與硬化劑混合後(A+B) 24 小時 hr
基板表面處理 Substrate surface treatment	酸處理及研磨 Acid micro etching 5% H ₂ SO ₄ & mechanical brushing
塗佈 Coating	網版印刷 Screen printing : 網目 Mesh 90 ~ 130 濕膜厚度 Wet film thickness : 25 ~ 30 μm
預熱乾燥 Preheat drying	單面印刷 Single layer 75°C, 20 ~ 30 分鐘 minutes 雙面印刷 Double layer 75°C, 45 ~ 60 分鐘 minutes
靜置冷卻	靜置冷卻板面溫度至室溫
曝光條件(mj/cm ²) UV Exposure energy on resist surface	350 ~ 500 mj/cm ² (到達底片下實際能量)
靜置	10 ~ 25 分鐘 minutes
顯影條件 Development	顯影液 : 1.0 ~ 1.2% Na ₂ CO ₃ 碳酸鈉水溶液 溫度 : 30 ± 2°C 水洗壓力 : 1.5 ~ 2.0kg 時間 : 60 ~ 90 秒
後固化 Post curing	150°C 60 分鐘 minutes 若進行塞孔製程請依三段式烘烤： 第一段 : 80°C / 20mins 第二段 : 120°C / 20mins 第三段 : 160°C / 60mins

以上各項數據的僅供參考

The above information is for reference only.